

## 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	杭州沃驰投资、杭州德创投资、杭州瀚臻投资、华西证券、国泰海通、重鼎资产、广发证券、卡比尔基金、中信证券、允朗投资、华泰证券、君桐资本、红马资本、探骊私募基金
时间	2026年6月10日
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：纪臻
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍环节</p> <p style="padding-left: 2em;">简单介绍公司发展历程和业务情况。</p> <p>二、问答环节</p> <p><b>Q1：公司有哪些产品线布局？会有哪些增长点？</b></p> <p><b>答：</b>公司始终专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，深耕带有高精度 ADC 的信号处理 SoC 芯片技术，面向医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理等下游终端应用市场，整合算法及应用解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。此外，为更好满足现有客户需求并与现有产品线形成配套（如医疗健康领域的动态血糖监测 CGM、电池管理领域的两轮车应用等），实现</p>

	<p>“AFE+MCU+无线传输+数据分析+应用方案”的全链条服务能力，公司于 2025 年新设了物联网无线传输产品线。物联网无线传输市场空间广阔，该布局也将助力公司拓展增量市场。未来公司增长将主要依托现有核心产品线在医疗健康、工控仪表、智能家电等领域的持续深耕与市场渗透，同时积极培育电池管理、物联网无线传输等新兴业务。</p> <p>Q2：公司产品线的营收占比和毛利率情况如何？</p> <p>答：2026 年一季度，公司医疗健康芯片产品收入占比为 37.36%，工业仪表芯片产品收入占比为 38.83%，智能感知芯片产品收入占比为 22.52%，电池管理芯片产品收入占比 1.29%。前述各产品线 2025 年度的毛利率分别是 35.34%、77.28%、30.45%和 18.57%。2026 年一季度公司主营业务毛利率 50.57%，其中晶华微主营业务毛利率 56.22%，子公司晶华智芯主营业务毛利率 30.08%。</p> <p>Q3：公司研发投入的情况？</p> <p>答：2025 年度，公司保持高强度的研发投入，研发费用 9,705.66 万元，同比增长 33.00%，占营业收入比重为 55.91%。截至报告期末，公司研发人员 138 名，占员工总数 61.06%。2025 年度，公司新立项芯片研发项目 18 个，同比增长 125.00%，公司在研芯片项目数量同比增长 36.96%，流片次数同比提升 112.50%，研发活动保持高活跃度。公司近两年研发投入较大，主要系围绕长期竞争能力提升，持续强化研发、丰富产品矩阵及人才引进等方面的资源保障，公司将加快推进新产品研发与量产进程，为公司长期发展储备增长动力。</p> <p>Q4：国产替代方面，公司与国外厂商相比在技术上有哪些优势？</p> <p>答：公司在工业控制芯片领域深耕多年，2008 年已成功攻克工控 HART 调制解调器芯片的国产化替代设计，并实现规</p>
--	---

	<p>模出货。2013 年成功研发基于环路供电的 16-bit 高精度 4~20mA 电流 DAC 芯片 SD2421，可兼容替代亚德诺（ADI）的 AD421 系列芯片，并于 2021 年推出第二代 4~20mA 电流环 DAC 芯片 SD24A421，精度、温漂等参数指标接近国外同类竞品。公司的核心技术竞争优势主要体现在基于自主研发的高精度 Sigma-Delta ADC 的 SoC 技术以及低功耗高抗干扰能力的工控仪表芯片技术，在国内处于比较先进的水平；其次是整合方案的优势，拥有应用开发团队，能为客户提供整体解决方案；第三是本土化快速反应的优势，只要客户反馈，公司会在第一时间安排技术人员满足客户需求。</p> <p><b>Q5：请介绍下公司 BMS 产品领域的情况？</b></p> <p>答：公司已构建覆盖单节高精度锂电保护芯片、3-17 串 BMS 模拟前端芯片和电量计芯片的完整解决方案，满足消费电子、电动工具，智能清洁家居到轻型电动车、无人机和储能系统等多元化应用场景的需求。2025 年度，公司 BMS 芯片已成功导入多家客户实现批量出货，并逐步导入行业头部客户和知名终端品牌，产品性能与可靠性得到市场验证和认可，产品规模放量销售尚需时间，收入占比较小。</p> <p><b>Q6：公司 2025 年报计提商誉减值的主要原因是什么？后续是否有相关改善安排？</b></p> <p>答：报告期内，受市场变化、竞争加剧和新产品推出延期等因素影响，晶华智芯经营业绩不及预期，存在商誉减值迹象，公司计提商誉减值准备 3,377.96 万元。公司将加快新产品的市场导入节奏，同时推进各产品线研发和市场资源的整合协同，努力改善公司经营状况。</p> <p><b>Q7：是否会继续关注并购机会？</b></p> <p>答：考虑到行业周期发展的情况，公司会适当关注并购机</p>
--	---

	<p>会。若有具体并购计划或实质性进展，公司将严格按照相关法律法规及信息披露要求，及时履行审议程序并对外公告。</p> <p>Q8：在 AI 人工智能、机器人等领域，公司是否有相关布局？</p> <p>答：公司暂未涉及人工智能领域。公司新一代信号调理及变送输出芯片在压力传感器、温度传感器、液位传感器等应用的基础上，已成功导入机械臂、机器人力传感器应用。公司产品下游应用领域众多，对新形势下带来的产业发展机会，公司会积极关注并谨慎评估业务机会，并持续加大研发创新。</p>
附件清单	无
日期	2026年6月11日